Q1. 公司如何看待 2026 年下半年及 2027 年前半導體產業與半導體晶圓需求展望？

A：

公司對 2026 年第 4 季至 2027 年上半年的半導體晶圓需求展望維持正向。公司觀察到全球半導體市場成長動能持續增強，人工智慧（AI）、高頻寬記憶體（HBM）及先進運算仍為主要成長引擎，並帶動記憶體及相關半導體需求維持強勁；成熟製程亦受惠於庫存正常化，以及功率、類比、工業與車用需求回升。隨著 AI 應用持續擴展，市場復甦亦逐步由先進製程延伸至更多終端應用。

從中長期來看，AI 基礎設施持續擴張，全球主要半導體製造商亦積極推進長期產能布局，加上 HBM、先進封裝及高速資料傳輸等技術持續演進，將進一步提升單一系統的晶圓使用量。隨下游客戶新建晶圓廠及產線陸續投產，矽晶圓需求仍具成長空間。相較之下，新增矽晶圓供給從設備建置、客戶認證至量產所需時間較長，且不同尺寸、規格及認證產能無法完全替代，供給難以立即跟上需求。公司預期 2027 年供需緊張程度將較 2026 年更為顯著。整體而言，公司持續看好半導體晶圓需求的結構性成長，並將靈活因應不同產品及終端市場的復甦步調。

Q2. 環球晶圓目前產能利用及全球擴產成果如何？

A：

儘管第三季短期受到義大利廠火災事件影響，**環球晶圓既有各尺寸晶圓產能維持滿載，全球其他主要生產據點營運表現持續提升。**近年提前投入的全球產能布局亦逐步進入收成階段，隨著主要新建及擴建產能陸續完成，公司營運重心逐步由廠房及設備建置轉向客戶認證、量產爬坡及營運效率提升。

美國德州新廠出貨量已連續四個月創下歷史新高；美國密蘇里州廠 12 吋 SOI 第三季產出亦創歷史新高。歐洲方面，義大利 Novara 廠新建 12 吋產線持續提升產能並推進客戶認證，量產出貨穩步增加並連月創新高；日本宇都宮廠產能利用率維持高檔，第三季出貨量再創新高，新潟廠第三季營收亦刷新歷史紀錄。

在既有產能維持滿載、新增產能逐步放量的雙重帶動下，公司提前投入全球產能布局並逐步轉化為營運成長動能，不僅強化客戶的供應保障，也為掌握下一階段市場成長機會奠定基礎。

Q3. 12 吋 SOI 需求為何快速成長？公司下一階段產能規劃為何？

A：

12 吋 SOI 需求持續成長，主要受惠於 SOI 晶圓由 8 吋向 12 吋轉移，以及矽光子、RF-SOI 及 Power SOI 等應用需求快速增加。美國密蘇里州廠第三季 12 吋 SOI 產出創下歷史新高，目前客戶需求已超過公司既有擴產規劃，公司正加速產能爬坡及去瓶頸化，以因應持續成長的市場需求。

環球晶圓密蘇里州廠是美國唯一具備 12 吋 SOI 晶圓在地製造能力的生產基地，擁有專有的 SOI 層轉移技術，並由集團內部供應基板，實現垂直整合製造，無須仰賴外購基板。基於明確的客戶需求及長期合作基礎，公司正評估下一階段產能擴充，並透過長期供貨協議（LTA）及相關合作安排強化需求能見度，在掌握 SOI 市場長期成長機會的同時，兼顧產能布局與投資效益。

Q4. AI 應用持續擴展，將如何帶動不同晶圓產品需求，並影響公司的高附加價值產品布局？

A：

AI 帶動的半導體需求已由先進運算逐步向更多應用領域擴展。除 AI 加速器、先進邏輯及 HBM 等產品外，AI 資料中心規模與功耗持續提升，亦同步增加高速資料傳輸、電源管理及能源基礎設施相關需求；此外，車用及工業市場隨庫存調整及基礎建設投資逐步改善，使整體市場復甦更加多元。

另一方面，先進封裝、晶圓鍵結與高速資料傳輸等技術持續演進，不僅提升單一系統的晶圓使用量，也帶動對高規格及特殊晶圓材料的需求。環球晶圓持續布局 SOI、氮化鎵（GaN）、12 吋碳化矽（SiC）及方形晶片等高附加價值產品，掌握 AI、能源管理、電源轉換及先進封裝等新興應用所帶來的長期成長機會。

Q5.在半導體產能持續擴張下，公司既有認證產能及全球在地供應布局將如何轉化為長期競爭優勢與成長動能？

A：

隨著全球半導體製造商積極推進長期擴產計畫，新建半導體及材料產能所需的建廠成本、設備交期及客戶認證門檻亦同步提高。矽晶圓為半導體製造的關鍵材料，其品質與穩定供應直接影響後續製程及良率，因此，在產業需求與產能利用率持續提升的環境下，具備成熟量產能力、客戶認證基礎及穩定供貨實績的晶圓產能，其策略價值更加凸顯。

環球晶圓已在亞洲、美洲及歐洲建立完整的製造與服務網絡，並具備多元產品組合與跨廠協作能力，可依客戶區域化需求提供在地供應及一站式解決方案（One-Stop Solution）。相較於新建產能仍需歷經廠房建置、設備導入及客戶認證，公司提前建立的量產能力與客戶合作基礎，使公司得以更靈活回應全球供應鏈調整及區域化製造需求，將先行布局轉化為長期競爭優勢。

Q6. 完成 GDR 募資後，環球晶圓的財務結構與未來成長彈性有何改變？

A：

環球晶圓於 2026 年 9 月完成全球存託憑證（GDR）發行，募資總額約 14.32 億美元，認購需求約為發行規模的四倍。募資完成後，公司財務結構由淨負債轉為淨現金，整體財務結構及資金彈性進一步提升，為後續全球產能布局與成長機會提供更充足的資源。

本次募集資金將用於支應原幣原物料採購及海外子公司產能擴充。未來，公司將持續以明確客戶需求、投資效益及財務紀律為重要考量，審慎評估既有廠區擴建及新產能投資，在掌握下一階段產業成長機會的同時，維持充足的財務彈性與資本配置效率。